강의계획서

직무				능력단위/책무(Duty)				능력단위코드					
교과목명	반도체공정장비			이수구분 전공필수			담당	상교수	김도영				
학년-학기				학점					시수(이	론/실습)			
교과목표 (학습목표)	1. 반도체공정 환경(클린룸, 웨이퍼, 케미컬)을 이해할 수 한다. 2. 반도체공정장비의 구조와 유틸리티간의 연결을 확인할 수 있다. 3. 반도체공정장비의 동작원리와 유지보수방법을 수행할 수 있다.												
교수학습방법	이론강의/실습/발표												
교육장소 (시 설)													
	주 교재 NCS			NCS 학습모듈									
교재 (NCS 학습모듈)	부 교재 :		울산고	울산과학대학교 반도체공정장비 실습(상), 반도체공정장비 실습(하)									
	참고 교재 null												
	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	М
평가방법													
	A.포트폴리오, B.문제해결시나리오, C.서술형시험, D.논술형시험 , E.사례연구, F.평가자 질문, G.평가자 체크리스트, H.피평가자 체크리스트, I일지/저널, J.역할연기, K.구두발표 L, 작업장 평가, M.기타												
성적평가형태													
가상강의													

관련	수행준거	지사 기스 대도
능력단위요소 /작업(Task)	구영군기	지식. 기술. 태도

조치기준

L	

Page 2 of 3

주차별 학습내용					
차시	관련 능력단위요소	수업내용(수행준거)			
1 大ト人	오리엔테이션	오리엔테이션 01			

1777	진단평가	진단평가 01
2차시		반도체공정환경 (클린룸)
3차시		반도체공정재료 (웨이퍼, 케미컬, 공정가스)
4차시		반도체공정장비 0 (전체공정설명)
5차시		반도체공정장비 1 (세정공정)
6차시		반도체공정장비 2 (산화공정)
7차시		반도체공정장비 3 (포토공정)
744		
8차시		반도체공정장비 4 (에칭공정 - 습식)
9차시		반도체공정장비 5 (에칭공정 - 건식)
10차시		반도체공정장비 6 (확산공정)
11차시		반도체공정장비 7 (증착공정)
12차시		
13차시		반도체공정장비 8 (금속공정)
		반도체공정장비 9 (검사 및 분석공정)
14차시		반도체공정장비 10 (패키징공정)
15차시		반도체공정장비 11 (모듈공정)